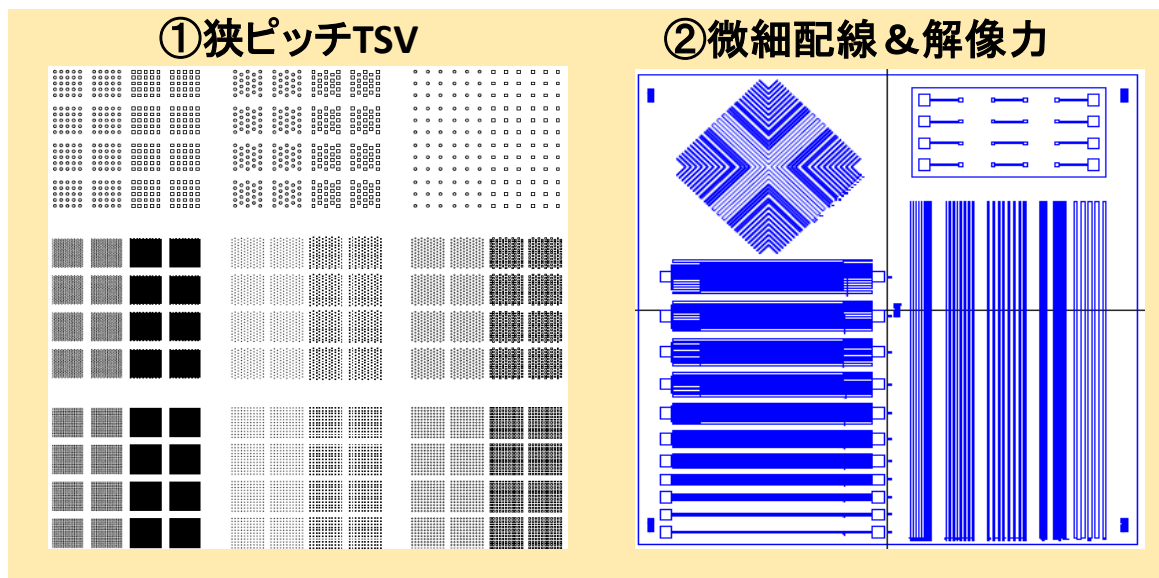


SI 15 TEG

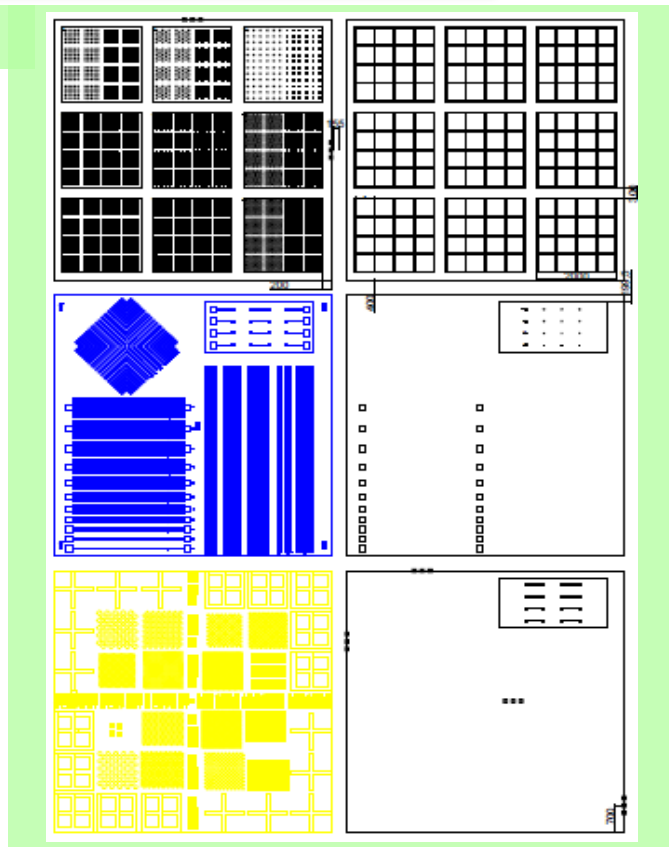
【背景】

狭ピッチTSV、微細配線評価を目的にSI 15 TEGを作成した。
1 μm 以下の微細配線形状(凹/凸)について、その実現性や一部の電気特性(マイグレーション等)の評価が可能である。

【設計概要、イメージ】



全体図

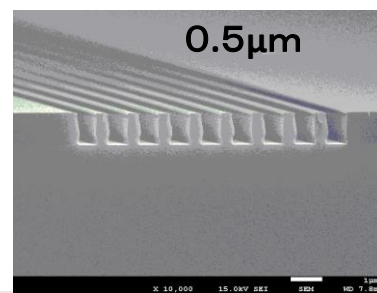
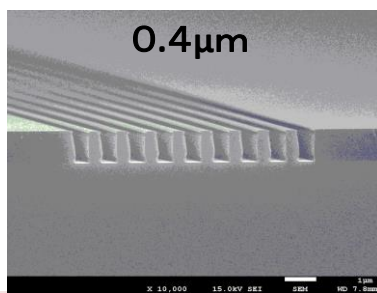
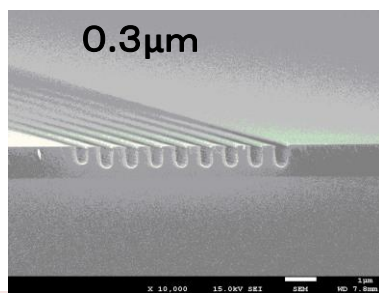


【開発内容】

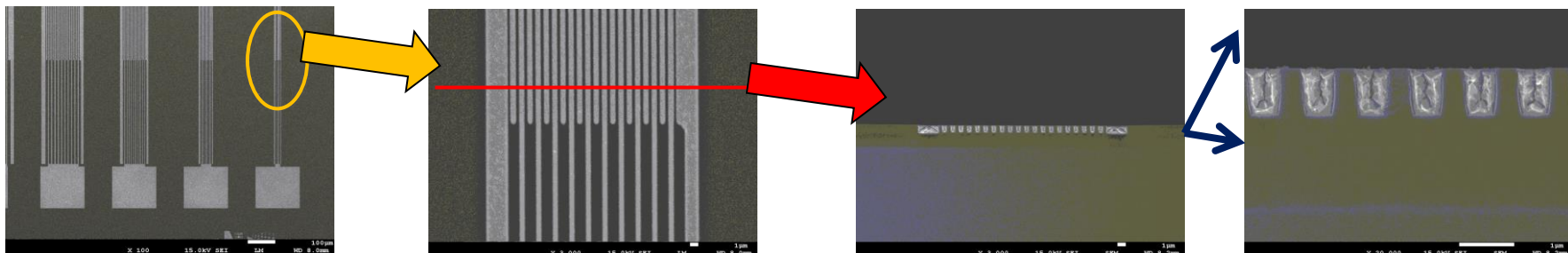
- ①狭ピッチTSV : 1.0 μm \circ / \square \Rightarrow 2.0 μm ピッチ、4.0 μm ピッチ
2.0 μm \circ / \square \Rightarrow 4.0 μm ピッチ
4.0 μm \circ / \square \Rightarrow 8.0 μm ピッチ
- ②微細配線 : 0.5 μm 、1、2、3、4、5 ~ 10 μm 櫛歯 & PAD、
.3 μm 、0.4 μm 、0.5 μm ~ 1.0 μm 、1.0 μm 、2.0 μm 、5.0 μm スペース

【評価結果および評価進捗状況】

◆解像力評価



◆微細配線形成 (0.5 μm)



【研究課題および今後への動き】

- ◆微細配線形成方式 : セミアジティブ方式の可能性
- ◆微細配線の電気特性評価 : Open / Short、マイグレーション